



Think Automation and beyond...

2019年3月第3四半期 テレフォンカンファレンス資料

2019年2月1日

IDEC株式会社

証券コード:6652

2019年3月期 第3四半期
(2018年4月1日～2018年12月31日)
決算ご説明資料

売上

- **売上高** 475億円 (前年同期比 + 6.7%)
 - 国内外で主力のHMIソリューション製品や、安全・防爆ソリューション製品、オートメーションソリューション製品などが伸長
 - 海外も引き続き好調に推移しているものの、中国市場は第3四半期より減速傾向
 - 前期よりグループ化したAPEMやウェルキャットに加え、当期グループ化した東京センサなどの業績が堅調に推移

利益

- **営業利益** 48億円 (前年同期比 + 1.3%)
- **経常利益** 49億円 (前年同期比 Δ 5.6%)
- **四半期純利益[※]** 33億円 (前年同期比 Δ 23.0%)
 - 為替差損益の影響などから経常利益は減少
 - 国内外における事業再編による固定資産売却益を計上したものの、事業整理損の計上により、四半期純利益は減少

※ 親会社株主に帰属する四半期純利益

連結業績概要<連結損益計算書>-1



2019年3月期 第3四半期累計 業績概要

(単位:百万円)	19.3月期 3Q累計			18.3月期 3Q累計	
	実績	対売上比	前年同期比	実績	対売上比
売上高	47,582	100.0%	+ 6.7%	44,581	100.0%
売上総利益	20,584	43.3%	+ 5.6%	19,486	43.7%
販売費及び一般管理費	15,752	33.1%	+ 7.0%	14,718	33.0%
営業利益	4,832	10.2%	+ 1.3%	4,767	10.7%
経常利益	4,904	10.3%	△ 5.6%	5,194	11.7%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,321	7.0%	△23.0%	4,311	9.7%
1株当たり四半期純利益 (潜在株式調整前)	101.02円	—	△40.08円	141.10円	—
USDレート (円)	111.15円		△0.54円	111.69円	—
EURレート (円)	129.46円		+0.91円	128.55円	—

連結業績概要<連結損益計算書>-2



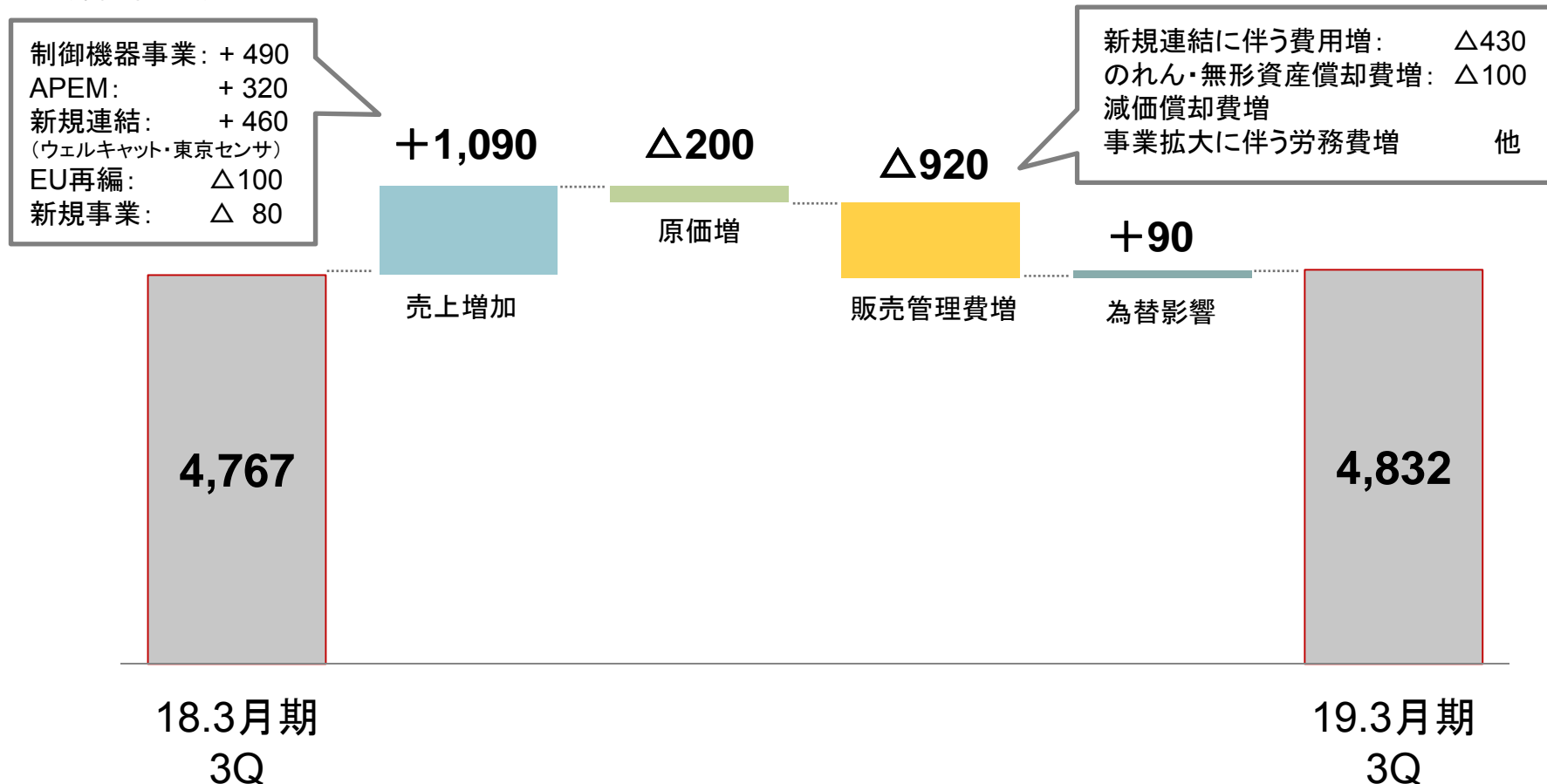
四半期別 業績概要

(単位:百万円)	18.3月期				19.3月期						
	3Q(10月~12月)		4Q(1月~3月)		1Q(4月~6月)		2Q(7月~9月)		3Q(10月~12月)		
	実績	対売上比	実績	対売上比	実績	対売上比	実績	対売上比	実績	対売上比	前年同期比
売上高	15,282	100.0%	15,202	100.0%	15,493	100.0%	16,358	100.0%	15,730	100.0%	+ 2.9%
売上総利益	6,655	43.5%	6,535	43.0%	6,882	44.4%	7,009	42.9%	6,691	42.5%	+ 0.5%
販売費及び一般管理費	4,982	32.6%	5,190	34.1%	5,307	34.3%	5,290	32.3%	5,153	32.8%	+ 3.4%
営業利益	1,673	10.9%	1,344	8.9%	1,575	10.2%	1,718	10.5%	1,538	9.8%	△ 8.1%
経常利益	1,578	10.3%	1,290	8.5%	1,604	10.4%	1,820	11.1%	1,479	9.4%	△ 6.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,270	8.3%	984	6.5%	1,443	9.3%	954	5.8%	923	5.9%	△27.4%
1株当たり 四半期純利益 (潜在株式調整前)	41.05円		29.97円		43.95円		29.02円		28.07円		

連結営業損益変動要因

増収効果による収益増の一方、原材料価格や人件費の高騰などによる原価の増加や、品質改善・事業拡大に向けた設備投資や拠点再編、買収に伴う販売管理費増加などの影響により前期比で約1億円増加

(単位:百万円)



地域別売上状況



地域別売上状況

単位:百万円
(構成比)

	19.3月期 3Q累計	18.3月期 3Q累計	前年同期比
日本	22,076 (46.4%)	20,864 (46.8%)	+ 5.8%
海外	25,506 (53.6%)	23,716 (53.2%)	+ 7.5%
米州	7,454 (15.7%)	6,879 (15.4%)	+ 8.4%
EMEA (欧州、中東、アフリカ)	8,403 (17.7%)	7,342 (16.5%)	+14.4%
アジア・ パシフィック	9,647 (20.3%)	9,494 (21.3%)	+ 1.6%
合計	47,582 (100.0%)	44,581 (100.0%)	+ 6.7%

日本 前年同期比 **+ 5.8%**

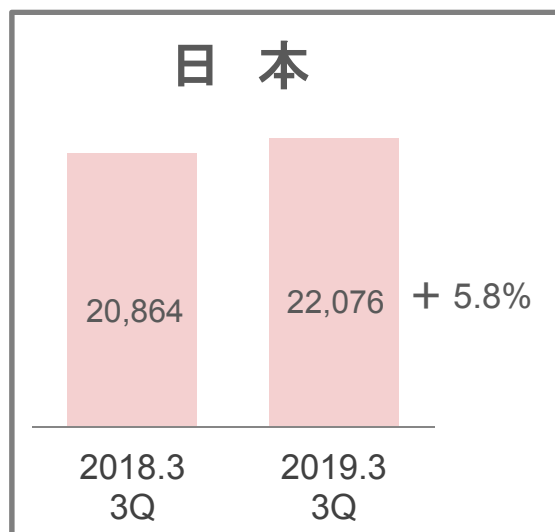
(※既存制御機器事業は、前年同期比+8.0%)

- 環境関連事業の売上が減少したものの、HMIソリューション製品や安全・防爆ソリューション製品などの売上が堅調に推移
- 新たにグループ会社に加わった、ウェルキャットや東京センサの売上が寄与

海外 前年同期比 **+ 7.5%**

- 各地域でHMIソリューション製品、安全関連機器の売上が伸長
- 欧州を中心にAPEMの売上が伸長
- アジア・パシフィックでは、売上は引き続き増加しているものの、中国の成長は鈍化傾向

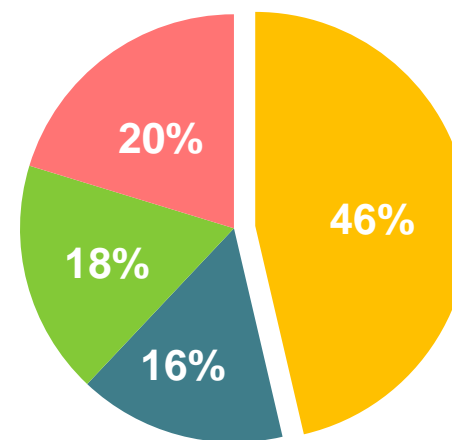
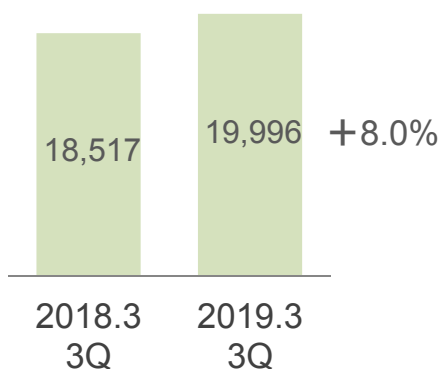
地域別売上状況



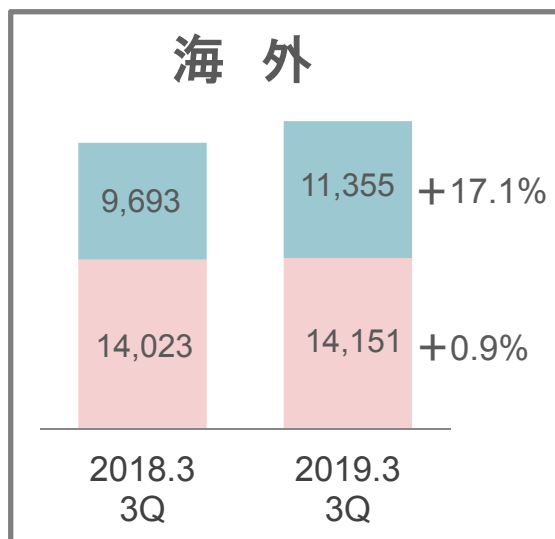
■ IDEC売上 ■ APEM売上 (単位:百万円)

【売上高比率】

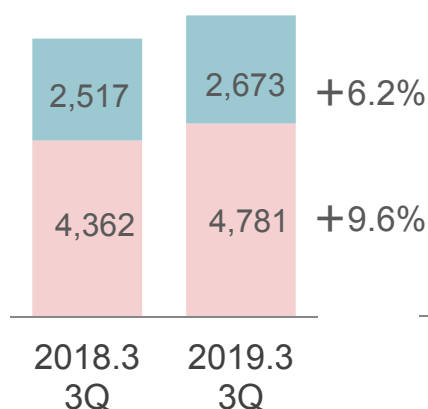
※日本における
既存制御機器事業の売上



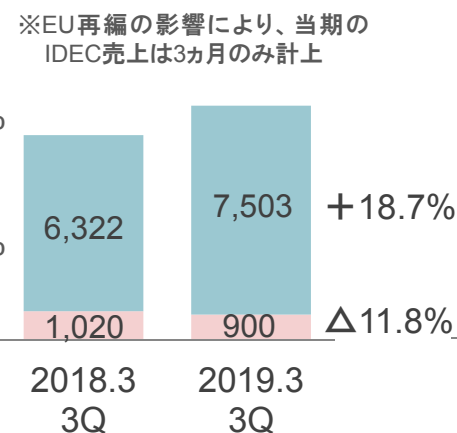
■ 日本 ■ 米州 ■ EMEA ■ アジア・パシフィック



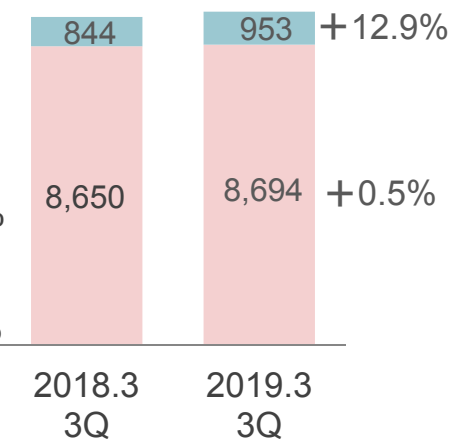
米州



EMEA



アジア・パシフィック



製品別売上状況



製品別売上状況

単位:百万円 (構成比)	19.3月期 3Q累計	18.3月期 3Q累計	前年同期比
HMIソリューション	22,566 (47.4%)	21,042 (47.2%)	+ 7.2%
盤内機器ソリューション	8,794 (18.5%)	8,460 (19.0%)	+ 4.0%
オートメーションソリューション	6,461 (13.6%)	5,807 (13.0%)	+ 11.2%
安全・防爆ソリューション	5,320 (11.2%)	4,691 (10.5%)	+ 13.4%
システム	2,358 (5.0%)	2,231 (5.0%)	+ 5.7%
その他	2,080 (4.4%)	2,346 (5.3%)	△11.4%
合計	47,582 (100.0%)	44,581 (100.0%)	+ 6.7%

HMIソリューション

APEM製品が伸長し、制御用操作スイッチも好調に推移

盤内機器ソリューション

制御用リレーなどの売上が伸長

オートメーションソリューション

ウェルキャットの自動認識機器の売上が2017年10月より寄与したことに加え、プログラマブルコントローラの売上也堅調に推移

安全・防爆ソリューション

東京センサの売上が2018年7月より寄与したことに加え、安全関連機器、防爆関連機器も伸長

システム

半導体・液晶製造装置用の制御盤などの売上が堅調に推移

その他

環境関連事業の売上が減少

連結業績概要 <連結貸借対照表>



2019年3月期 第3四半期 連結貸借対照表概要

資産のポイント

- たな卸資産や有形固定資産が増加したものの、売上債権の減少やのれんなど無形固定資産が償却により減少したことなどにより、総資産は前期末比約3億円減少

負債のポイント

- 再生可能エネルギー事業の推進により前受金が増加した一方、未払費用や未払法人税などが減少したことなどにより、負債は前期末比約12億円減少

純資産のポイント

- 利益剰余金が増加した一方、為替換算調整勘定や非支配株主持分が減少したことなどにより、純資産は前期末比約9億円増加

(単位:百万円)

科目	19.3月期 (12月末)	18.3月期 (前会計年度末)	前会計年度末比 増減
流動資産	39,510	39,873	△ 362
固定資産	51,769	51,657	+ 112
流動負債	20,988	26,953	△5,964
固定負債	24,056	19,284	+4,771
純資産	46,235	45,292	+ 942
総資産	91,280	91,530	△ 250
自己資本比率	50.6%	49.2%	

2019年3月期 第3四半期 連結キャッシュ・フロー計算書概要

営業活動によるCF

- たな卸資産の増加に加え、法人税等を納付した一方、売上債権の減少や四半期純利益の計上などにより、約53億円となった

投資活動によるCF

- 主に、国内外の事業所再編による固定資産の売却や取得に加え、子会社株式の取得などにより、約△24億円となった

財務活動によるCF

- 主に、配当金の支払いや、短期および長期借入金の返済などにより、約△28億円となった

(単位:百万円)

	19.3月期 3Q累計	18.3月期 3Q累計	前年同期比増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,306	2,865	+2,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,446	△209	△2,237
フリー・キャッシュ・フロー(FCF)	2,859	2,656	+ 203
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,820	2,288	△5,108
現金及び現金同等物の期末残高	12,362	17,367	△5,005
設備投資額	3,129	1,462	+1,666
減価償却費	1,959	1,751	+ 208

2019年3月期 連結業績予想
(2018年4月1日～2019年3月31日)

2019年3月期 連結業績予想



通期予想は変更しておりません

(単位:百万円)	19.3月期 予想 (日本基準)			18.3月期 (日本基準)		19.3月期 予想 (IFRS概算)	
	予想	対売上比	前期比	実績	対売上比	予想	対売上比
売上高	62,500	100.0%	+ 4.5%	59,783	100.0%	62,500	100.0%
売上総利益	28,000	44.8%	+ 7.6%	26,022	43.5%	28,000	44.8%
販売費及び一般管理費	20,800	33.3%	+ 4.5%	19,909	33.3%	20,000	32.0%
営業利益	7,200	11.5%	+17.8%	6,112	10.2%	8,000	12.8%
経常利益	7,100	11.4%	+ 9.5%	6,484	10.8%	7,900	12.6%
親会社株主に帰属する 当期純利益	5,100	8.2%	△3.7%	5,296	8.9%	5,900	9.4%
EBITDA	10,600	17.0%	+12.0%	9,463	15.8%	10,600	17.0%
USDレート (円)	110.00円			110.86円		—	
EURレート (円)	130.00円			129.66円		—	

参考資料

地域別受注状況

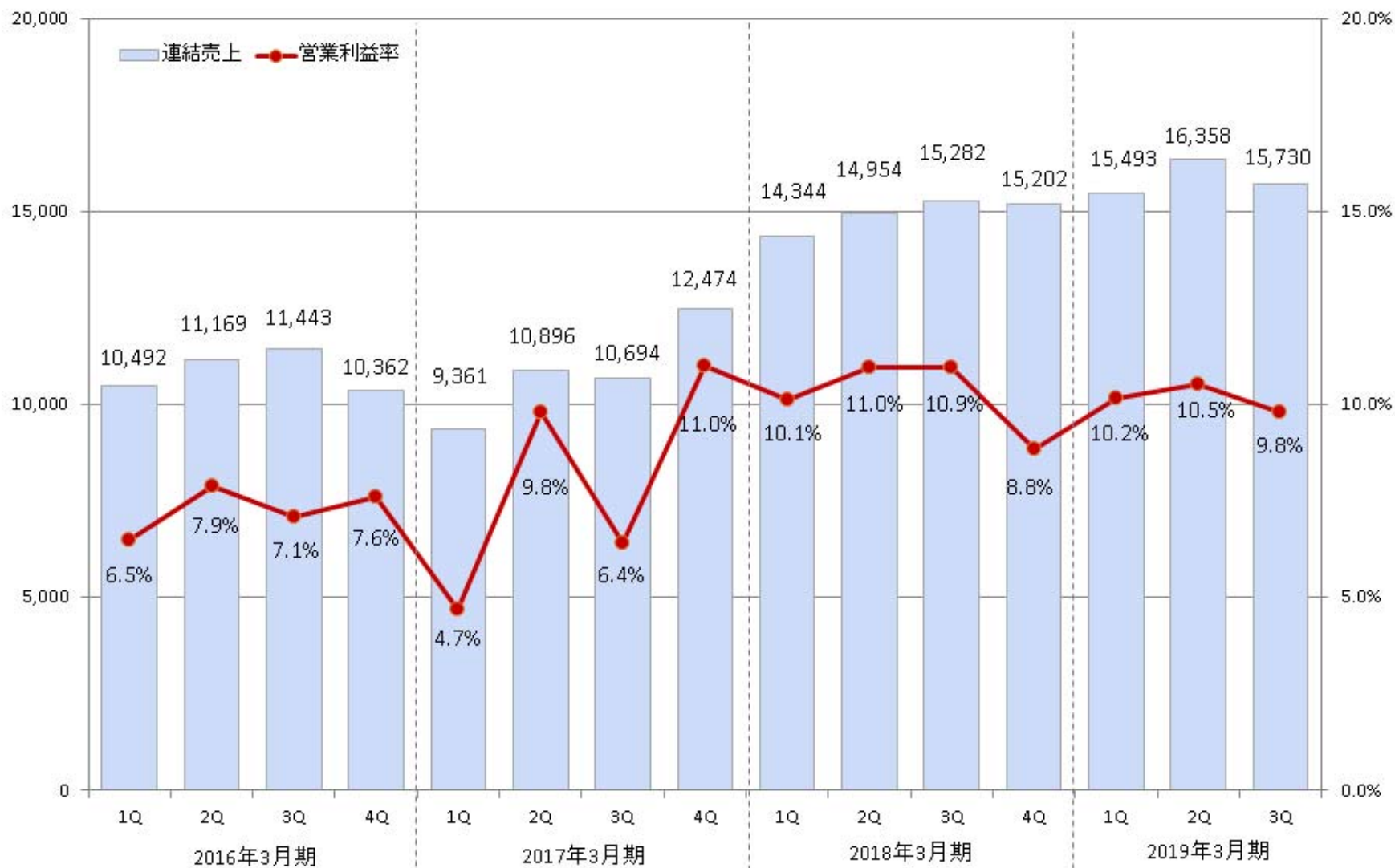
- **日本**: 前期は環境関連事業の受注が入っていたことに加え、足元では若干スローダウン
- **米州・EMEA**: 引き続き好調な受注状況が継続
- **アジア・パシフィック**: 第3四半期以降、主に中国の受注状況が前期比で鈍化傾向

単位: 百万円

	19.3月期 3Q累計				18.3月期 3Q累計	
	受注高	前年同期比	受注残高	前年同期比	受注高	受注残高
日本	22,928	92.7%	5,103	82.2%	24,726	6,209
米州	7,799	109.0%	1,439	122.6%	7,156	1,174
EMEA (欧州、中東、アフリカ)	9,081	115.7%	3,697	133.8%	7,850	2,762
アジア・ パシフィック	5,949	91.1%	1,452	54.1%	6,530	2,686
合計	45,760	98.9%	11,693	91.1%	46,264	12,833

売上高・営業利益率 四半期推移

(単位：百万円)



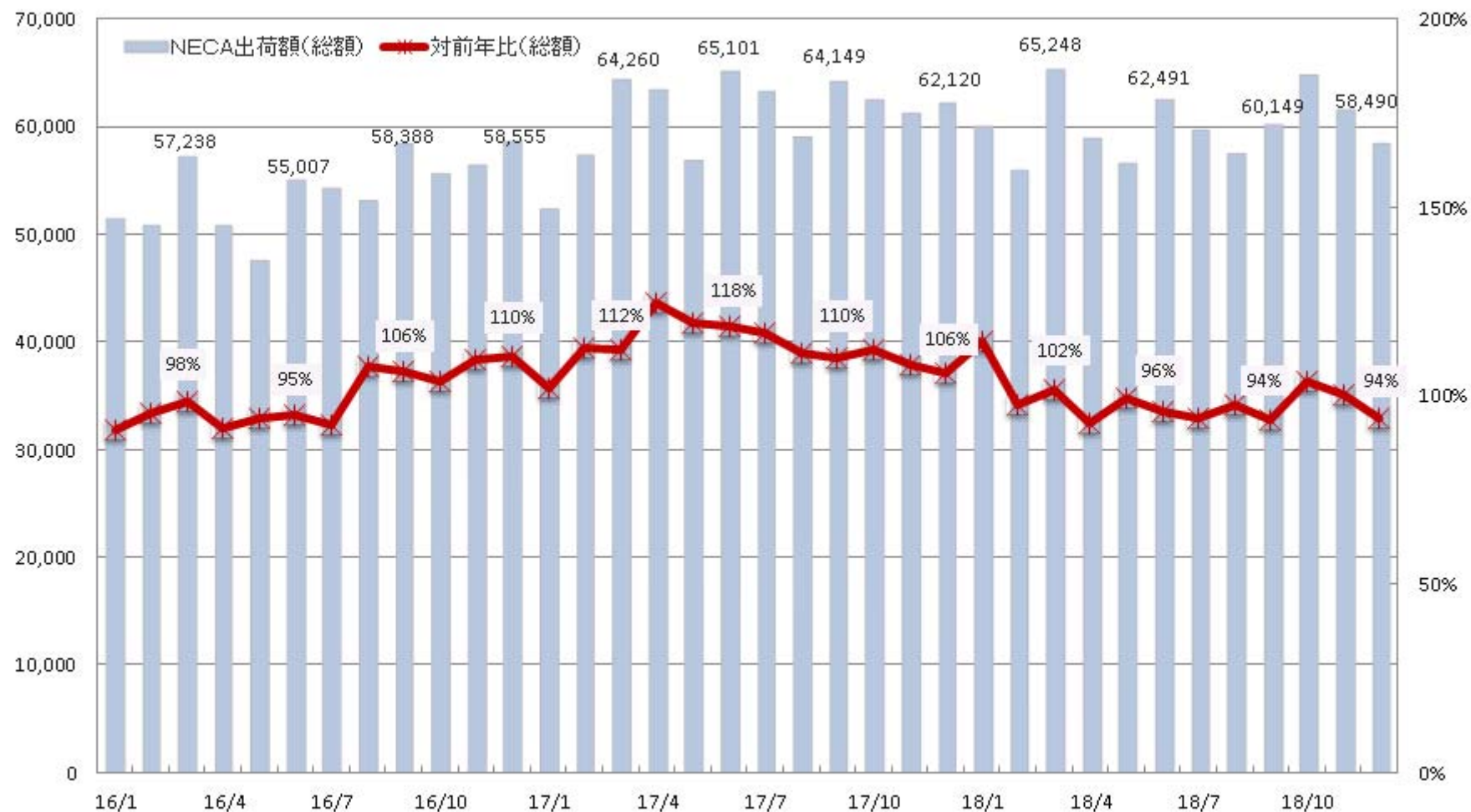
地域別売上高 四半期推移

(単位：百万円)



16年1月～18年12月の業界出荷額推移と対前年比の状況

(単位：百万円)



製品別売上状況

製品群

HMI	盤内機器	オートメーション	安全・防爆	システム	その他
<ul style="list-style-type: none"> 制御用操作スイッチ ジョイスティック 表示灯  <p>APEM製品</p> 	<ul style="list-style-type: none"> スイッチング電源 端子台 制御用リレー/ソケット サーキットプロテクタ 産業用LED照明 	<ul style="list-style-type: none"> プログラマブルコントローラ プログラマブル表示器 光電スイッチ 自動認識機器 	<ul style="list-style-type: none"> 安全関連機器 防爆関連機器 	<ul style="list-style-type: none"> 表示器複合システム セキュリティシステム その他各種システム 	<ul style="list-style-type: none"> 再生可能エネルギー事業 次世代農業ソリューション 協働ロボットシステム ウルトラファインバブル発生装置 

この資料には一部当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。従いまして、実際の業績などは、今後さまざまな要因によって計画、予想数値と異なる結果となる可能性があります。

IDEC株式会社

経営戦略企画部

TEL : 06-6398-2505

FAX : 06-7662-7551

E-mail : y.ogawa@jp.idec.com

